

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/06/10-2024/06/23）

部分存储企业上半年业绩预喜

2024年6月23日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

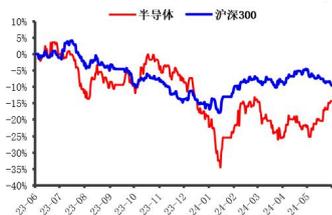
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

### 投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年6月21日，申万半导体板块近两周（2024/6/10-2024/6/21）上涨7.64%，跑赢沪深300指数9.83个百分点；6月以来累计上涨8.94%，跑赢沪深300指数11.29个百分点；2024年以来累计下跌7.46%，跑输沪深300指数9.34个百分点。
- **半导体行业指数子板块近两周涨跌幅：**截至2024年6月21日，申万半导体板块各细分指数近两周全面上涨，涨跌幅从高到低依次为：SW模拟芯片设计（11.42%）>SW分立器件（9.14%）>SW数字芯片设计（8.75%）>SW半导体材料（8.72%）>SW集成电路封测（7.03%）>SW半导体设备（3.94%）。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）4月全球半导体销售额自2023年12月以来首次出现环比正增长；（2）存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年Q1；（3）消息称台积电或将启动新一轮涨价谈判，主要针对5/3/2nm等先进制程；（4）TechInsights：今年全球先进封装设备销售金额将同比增长6%；（5）SEMI：全球半导体晶圆厂产能预计2024年增长6%，2025年增长7%；（6）美光科技考虑在马来西亚生产HBM；（7）Canalys：中国消费者对AI手机兴趣强烈；（8）普冉股份：4月至5月营业收入同比增长131%左右；（9）思瑞浦：拟发行可转债及支付现金购买创芯微100%股权；（10）江丰电子：超高纯金属溅射靶材进入国际知名半导体供应商名单；（11）佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏。
- **周报观点：AI创新与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。**进入2024上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产替代方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产替代进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。
- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

## 目录

1. 半导体行业行情回顾 .....	3
2. 半导体产业新闻 .....	4
3. 公司公告与动态 .....	6
4. 半导体产业数据更新 .....	7
4.1 智能手机出货数据 .....	7
4.2 新能源汽车销售数据 .....	7
4.3 全球、国内半导体月度销售数据 .....	8
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据 .....	8
5. 投资建议 .....	8
6. 风险提示 .....	11

## 插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2024 年 6 月 21 日) .....	3
图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/03) .....	7
图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/04) .....	7
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/01-2024/05) .....	7
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/01-2024/05) .....	7
图 6: 全球半导体月度销售情况 .....	8
图 7: 中国半导体月度销售情况 .....	8
图 8: 全球半导体设备销售额 (季度) .....	8
图 9: 中国大陆半导体设备销售额 (季度) .....	8

## 表格目录

表 1: 申万半导体行业各子板块涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 6 月 21 日) .....	3
表 2: 申万电子所有三级子行业涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 6 月 21 日) .....	3
表 3: 建议关注标的介绍 (2024/6/21) .....	9

## 1. 半导体行业行情回顾

**半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至 2024 年 6 月 21 日，申万半导体板块近两周（2024/6/10-2024/6/21）上涨 7.64%，跑赢沪深 300 指数 9.83 个百分点；6 月以来累计上涨 8.94%，跑赢沪深 300 指数 11.29 个百分点；2024 年以来累计下跌 7.46%，跑输沪深 300 指数 9.34 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 6 月 21 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2024 年 6 月 21 日，申万半导体板块各细分指数近两周全面上涨，涨跌幅从高到低依次为：SW 模拟芯片设计（11.42%）>SW 分立器件（9.14%）>SW 数字芯片设计（8.75%）>SW 半导体材料（8.72%）>SW 集成电路封测（7.03%）>SW 半导体设备（3.94%）。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 6 月 21 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	9.14	5.60	-18.36
2	850813.SL	半导体材料	8.72	9.62	-10.26
3	850814.SL	数字芯片设计	8.75	8.10	-3.88
4	850815.SL	模拟芯片设计	11.42	8.99	-21.07
5	850817.SL	集成电路封测	7.03	10.08	-2.90
6	850818.SL	半导体设备	3.94	11.63	3.44

资料来源：iFind、东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 6 月 21 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	8.72	9.62	-10.26
2	850818.SL	半导体设备	3.94	11.63	3.44
3	850814.SL	数字芯片设计	8.75	8.10	-3.88
4	850815.SL	模拟芯片设计	11.42	8.99	-21.07
5	850817.SL	集成电路封测	7.03	10.08	-2.90

6	850812.SL	分立器件	9.14	5.60	-18.36
7	850853.SL	品牌消费电子	-1.77	-7.53	-21.29
8	850854.SL	消费电子零部件及组装	10.13	8.50	0.12
9	850861.SL	电子化学品III	2.08	0.51	-13.72
10	850831.SL	面板	-1.57	-2.27	-11.61
11	850832.SL	LED	2.65	-2.80	-19.59
12	850833.SL	光学元件	5.56	0.45	-15.85
13	850822.SL	印制电路板	10.40	11.99	14.60
14	850823.SL	被动元件	1.38	0.86	-7.48
15	850841.SL	其他电子III	9.09	2.87	-10.21

资料来源：iFind、东莞证券研究所

## 2. 半导体产业新闻

### 1. 【SIA：4月全球半导体销售额自2023年12月以来首次出现环比正增长】

《科创板日报》18日讯，美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。按地区来看，美洲环比增长4.2%，达126.4亿美元，欧洲环比减少0.8%，降至42.5亿美元，日本环比增长2.4%，达35.9亿美元，中国环比增长0.2%，达141.7亿美元，不包括中日的亚太及其他地区环比减少0.5%，降至117.9亿美元。

### 2. 【供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空 订单能见度可达2026年Q1】

《科创板日报》18日讯，存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载，估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能，势必推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为，DDR5价格持续走扬态势明确，预期到了年底前还有10~20%涨幅，但若DDR5价格太高，反而可能拖延市场渗透率的起飞速度，影响下游客户采用的意愿。

### 3. 【消息称台积电或将启动新一轮涨价谈判 主要针对5/3/2nm等先进制程】

《科创板日报》18日讯，据悉台积电或将在下半年启动新的价格调涨谈判，主要是针对5nm和3nm，以及未来的2nm制程等，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。

### 4. 【三星将于今年内推出3D HBM芯片封装服务】

《科创板日报》17日讯，据三星内部和业内消息人士称，三星电子将在年内推出高带宽存储器（HBM）的三维（3D）封装服务，预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。

**5. 【IDC：今年 Q1 中国可穿戴设备市场出货 3367 万台同比增长 36.2%】**

《科创板日报》17 日讯，IDC 发布数据显示，2024 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 3367 万台，同比增长 36.2%，伴随销量增长，市场出货节奏明显加快。

**6. 【消息称群创与存储龙头厂接触 旗下面板厂或将投入 AI 封装应用】**

《科创板日报》17 日讯，消息人士透露，面板厂群创正与全球三大存储龙头之一接触，拟将旗下台南四厂（5.5 代 LCD 面板厂）投入 AI 相关的半导体领域，锁定后段封装应用。值得注意的是，群创正通过面板级扇外型封装进军玻璃基板封装业务。

**7. 【TechInsights：今年全球先进封装设备销售金额将同比增长 6%】**

《科创板日报》19 日讯，半导体市场研究机构 TechInsights 最新公布的 2024 年第一季度先进封装设备市场数据显示，2024 年用于先进封装的晶圆厂设备预计将同比增长 6%，达到 31 亿美元。

**8. 【SEMI：全球半导体晶圆厂产能预计 2024 年增长 6% 2025 年增长 7%】**

《科创板日报》18 日讯，SEMI 最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年实现 7% 的增长，达到每月晶圆产能 3370 万片的历史新高（以 8 英寸当量计算）。5 纳米及以下节点的产能预计在 2024 年将增长 13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能的驱动。为了提高处理效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产 2nm GAA 芯片，在 2025 年将总的先进产能增长率提高 17%。

**9. 【美光科技考虑在马来西亚生产 HBM】**

财联社 6 月 19 日电，知情人士透露，美光科技正在美国建设先进的高带宽存储器测试生产线，并考虑首次在马来西亚生产 HBM，以抓住人工智能热潮带来的更多需求。知情人士透露，美光科技正在扩建位于爱达荷州博伊西总部的 HBM 相关研发设施，包括生产和验证线。他们说，该公司还在考虑在马来西亚建立 HBM 生产能力。

**10. 【通用 DRAM 需求尚未恢复 三星和 SK 海力士相关工厂开工率 80%-90%】**

《科创板日报》19 日讯，据调查，通用 DRAM 的恢复趋势不及 NAND 闪存。目前三星电子和 SK 海力士的通用 DRAM 厂开工率为 80%-90%，较今年年初的 70%-80% 小幅增加，但尚未达到“全面启动”水平；供应仍然比需求占优势，主要原因在于智能手机、PC、服务器市场增长势头放缓，未能带动需求。与之形成鲜明对比的是 NAND 闪存，随着 AI 带动 eSSD 等需求恢复，三星、SK 海力士的相关工厂在二季度已转为全面启动机制，铠侠近期开工率也达到了 100%。

**11. 【Canalys：中国消费者对 AI 手机兴趣强烈】**

《科创板日报》21 日讯，根据 Canalys 最新报告，中国大陆是全球前三大智能手机市场中 AI 兴趣倾向最强的市场。在全球前三大智能手机市场中国、印度、美国中，具有“高”到“极高”AI 兴趣倾向的消费者占比最高，分别达到 31% 和 12%，

仅 1%消费者对 AI 毫无兴趣。中国大陆消费者在调查中展现出了对新技术更开放的态度，厂商在中国大陆更先机的 AI 消费者教育及营销投入对此有所贡献，为 AI 手机在中国大陆市场的发展培育了更优质的土壤。

### 3. 公司公告与动态

#### 1. 【江丰电子：超高纯金属溅射靶材进入国际知名半导体供应商名单】

财联社 6 月 18 日电，江丰电子在互动平台表示，公司生产的高纯金属溅射靶材是制造芯片互连导线的关键材料，在半导体芯片制造领域具有显著的技术优势和市场竞争能力，已成功打破美、日垄断，并进入国际知名半导体供应商名单。同时，公司生产的核心功能零部件填补了国产化空白，有力地促进了我国半导体工艺设备的自主发展。

#### 2. 【佰维存储：预计上半年净利润 2.8 亿元至 3.3 亿元 同比扭亏】

《科创板日报》18 日讯，佰维存储公告，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2.8 亿元至 3.3 亿元，上年同期亏损 2.96 亿元。本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。2024 年上半年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，2024 年半年度研发费用约为 2.1 亿元，同比增长超过 170%。

#### 3. 【南大光电：三款 ArF 光刻胶有少量销售】

财联社 6 月 18 日电，南大光电在互动平台表示，目前通过验证的三款 ArF 光刻胶有少量销售，质量稳定。具体量产进度需根据客户订单情况确定。公司正加速推进产品验证和市场拓展工作，争取早日实现量产。

#### 4. 【思瑞浦：拟发行可转债及支付现金购买创芯微 100%股权】

财联社 6 月 5 日电，思瑞浦公告，拟发行可转换公司债券及支付现金购买创芯微 100% 股权，并募集配套资金。此次交易对价为 10.6 亿元。此次交易完成后，创芯微将成为思瑞浦全资子公司。同时，思瑞浦拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。

#### 5. 【普冉股份：4 月至 5 月营业收入同比增长 131%左右】

《科创板日报》18 日讯，普冉股份公告，公司 2024 年 4 月至 5 月实现营业收入 3.38 亿元左右，较去年同期增长 131%左右。2024 年以来，随着下游市场的景气度逐渐复苏，公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升，公司 2024 年 1 月至 5 月出货量累计约 35 亿颗，较去年同期翻番，目前在手订单 1.7 亿元左右（含税），取得了良好的经营开局。

## 4. 半导体产业数据更新

### 4.1 智能手机出货数据

**全球智能手机出货数据:** 根据 IDC 数据, 2024 年第一季度全球智能手机出货量为 2.89 亿台, 同比增长 7.74%, 环比下降 11.25%; 2023 年全年智能手机出货量为 11.63 亿台, 相比 2022 年下滑 3.29%;

**国内智能手机出货数据:** 根据工信部数据, 2024 年 4 月国内智能手机出货量为 2,266.8 万台, 同比增长 25.50%, 环比增长 12.12%。2024 年 104 月国内智能手机累计出货量为 8,644.1 万台, 同比增长 10.33%。

图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/03) 图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/04)



资料来源: IDC, 东莞证券研究所

资料来源: 工信部, 东莞证券研究所

### 4.2 新能源汽车销售数据

**新能源汽车销售数据:** 据工信部, 2024 年 5 月, 国内新能源汽车总销量为 95.5 万辆, 同比增长 33.2%, 环比增长 39.51%, 2024 年 5 月国内汽车总销量为 241.7 万台, 其中新能源汽车销量占比为 39.51%。

图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/01-2024/05) 图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/01-2024/05)



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

### 4.3 全球、国内半导体月度销售数据

**全球、中国半导体销售数据：**根据美国半导体行业协会数据，2024 年 4 月全球半导体销售额 4,647.3 亿美元，同比增长 15.80%，环比增长 1.13%；国内半导体 2023 年 4 月销售额为 141.7 亿美元，同比增长 23.40%，环比增长 0.21%。

图 6：全球半导体月度销售情况

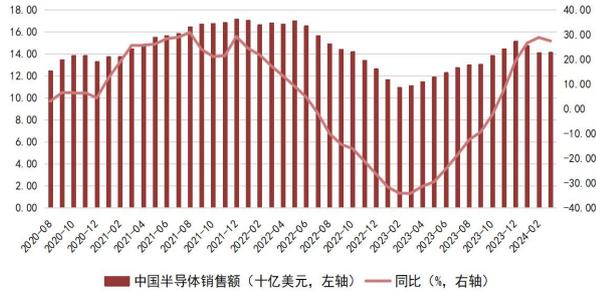


图 7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

### 4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

**全国、中国大陆半导体设备销售额：**根据 SEAJ 数据，2024 年第一季度全球半导体设备销售额为 264.2 亿美元，同比下降 2.00%，其中中国大陆半导体设备销售额为 125.2 亿美元，同比增长 113.00%。

图 8：全球半导体设备销售额（季度）



图 9：中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

## 5. 投资建议

**AI 创新与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。**进入 2024 上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块 Q1 业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI 大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI 手机、PC 开启行业新周期，关注存储、SoC 等增量环节；国产替代方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产替代进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有

重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。

**建议关注标的：**

- ▶ **半导体设备与材料：**北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)；
- ▶ **存储芯片：**兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、佰维存储(688525)；
- ▶ **模拟芯片：**圣邦股份(300661)；
- ▶ **先进封装：**长电科技(600584)、通富微电(002156)；
- ▶ **射频&CIS：**卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)、思特威(688213)；
- ▶ **算力芯片：**海光信息(688041)

表 3：建议关注标的介绍（2024/6/21）

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
002371	北方华创	公司 2023 年实现营收 220.79 亿元，同比增长 50.32%，实现归母净利润 38.99 亿元，同比增长 65.73%；公司 2024 年一季度实现营收 58.59 亿元，同比增长 51.36%，实现归母净利润 1.27 亿元，同比增长 90.40%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，不断提升核心竞争力，应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升；盈利能力方面，随着公司营收规模持续扩大，规模效应开始逐渐显现，成本费用率稳定下降，因此报告期内利润增速大于营收增速。
688012	中微公司	公司 2023 年实现营收 62.64 亿元，同比增长 32.15%，实现归母净利润 17.86 亿元，同比增长 52.67%；公司 2024 年第一季度实现营收 16.05 亿元，同比增长 31.23%，实现归母净利润 2.49 亿元，同比下降 9.53%。2024 年一季度，公司刻蚀设备持续获得国内外更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，其中度刻蚀设备实现收入 13.35 亿元，较上年同期增长约 64.05%，刻蚀设备占营业收入的比重由上年同期的 66.55% 提升至本期的 83.20%。费用支出方面，公司持续加大研发力度，积极推动多款新品研发，24Q1 研发投入同比增长约 62.43%，在业务扩张、人员增长背景下，公司销售费用和管理费用较上年同期分别增长 0.39 亿元和 0.18 亿元，拖累公司整体盈利表现。
688120	华海清科	公司 2023 年实现营收 25.08 亿元，同比增长 52.11%，实现归母净利润 7.24 亿元，同比增长 44.29%；公司 2024 年第一季度实现营收 6.80 亿元，同比增长 10.40%，实现归母净利润 2.02 亿元，同比增长 4.27%。2023 年，公司持续加大研发投入和生产能力建设，增强核心竞争力。其中，CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一，获得了更多客户的肯定并实现了多次批量销售，市场占有率不断提高；公司晶圆再生业务获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货，同时随着公司 CMP 产品的市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量，同期营业收入及净利润均实现较大幅度同比增长。
688072	拓荆科技	公司 2023 年实现营收 27.05 亿元，同比增长 58.60%，实现归母净利润 6.63 亿元，同比增长 79.80%；公司 2024 年一季度实现营收 4.72 亿元，同比增长 17.25%，实现归母净利润 0.10 亿元，同比下降 80.51%。公司 2024 年一季度归母净利润同比大幅下滑的主要原因为：新产品验收周期较长导致季节

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/6/21)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		性收入确认延后;24Q1 保持研发投入同比增幅较大导致利润承压。公司为国内薄膜沉积设备龙头企业,绑定本土客户有望受益行业国产化趋势,布局混合键合,打开企业成长空间。
300604	长川科技	公司 2023 年实现营收 17.75 亿元,同比下降 31.11%,实现归母净利润 0.45 亿元,同比下降 90.21%;公司 2024 年一季度实现营收 5.59 亿元,同比增长 74.81%,实现归母净利润 0.04 亿元,同比增长 107.12%。经营业绩拐点出现,盈利能力明显改善。作为国内半导体测试设备平台型企业,公司相比海外龙头企业规模偏小,布局测试机、分选机、探针台和 AOI 等多个产品线,成长空间持续打开。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年第一季度实现营收 7.08 亿元,同比增长 29.50%,实现归母净利润 0.82 亿元,同比增长 134.86%。公司 2023 年营业收入为 26.67 亿元,同比下降 2.00%,实现归母净利润 2.22 亿元,同比下降 43.08%。分业务来看,2024 年第一季度,公司 CMP 抛光垫实现销售收入 1.35 亿元,同比增长 110.08%,为全年抛光垫业务逐季度持续放量打下良好基础;公司 CMP 抛光液、清洗液实现产品销售收入 3,592 万元,环比增长 24.31%,同比增长 206.00%,各型号产品的上量、导入验证稳步推进;半导体显示材料业务实现产品销售收入 7,021 万元,环比持平略增,同比增长 436.49%,与下游重要面板客户的产品渗透和合作持续加深。
300666	江丰电子	公司 2024 年第一季度实现营收 7.72 亿元,同比增长 36.65%,实现归母净利润 0.60 亿元,同比增长 7.16%。公司 2023 年营业收入为 26.02 亿元,同比增长 11.89%,实现归母净利润 2.55 亿元,同比下降 3.35%。报告期内,受到全球经济环境、半导体行业周期等影响,公司归母净利润同比下滑,但公司始终积极扩大全球市场份额,营收规模实现增长;同时,公司持续加大研发投入,积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目,强化半导体精密零部件领域的战略布局,市场认可度不断提高。后续随着外围环境及行业周期好转公司的核心竞争力和盈利能力有望加强。目前,上述项目的扩产和推进,导致相应成本费用有所增加,同时受到产品销售结构变化、精密零部件和第三代半导体材料新品开发试制增加等多种因素影响,公司 2023 年经营业绩较上年同期有所下降。
603986	兆易创新	公司 2023 年实现营收 57.61 亿元,同比下降 29.14%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比下降 92.15%;公司 2024 年一季度实现营收 16.27 亿元,同比增长 21.32%,实现归母净利润 2.05 亿元,同比增长 36.45%,一季度归母净利润超过 2023 年总和。公司作为国内利基型存储与 MCU 领先企业,在 Nor Flash、SLC Nand Flash、DRAM 和 MCU 等产品均有布局。2024 年第一季度,伴随下游消费市场需求回暖及产品价格企稳,叠加通过提升销量扩大市占率,公司多条产品线如 Nor Flash、DRAM 产品出货量稳步增加,24Q1 经营业绩实现强势反弹。
688008	澜起科技	公司 2023 年实现营收 22.86 亿元,同比下降 37.76%,实现归母净利润 4.51 亿元,同比下降 65.30%;公司 2024 年一季度实现营收 7.37 亿元,同比增长 75.74%,实现归母净利润 2.23 亿元,同比增长 1,032.86%。2023 年一季度,内存接口芯片实现恢复性增长,公司部分芯片开始规模出货,推动营收及净利润较上年同期大幅增长;营收结构方面,公司 DDR 内存接口芯片、PCIe Retimer 及 MRCD/ MDB 芯片等较高毛利率产品收入占比提升,公司互联类芯片产品线毛利率较上年同期增加 6.98 个百分点,推动公司整体毛利润较上年同期增长 90.29%。
688525	佰维存储	公司 2023 年实现营收 35.91 亿元,同比增长 20.27%,实现归母净利润-6.24 亿元,同比下降 976.68%;公司 2024 年一季度实现营收 17.27 亿元,同比增长 305.80%,实现归母净利润 1.68 亿元,同比增长 232.97%。自 2023 年第四季度起,存储行业展现出复苏迹象,市场需求逐渐增强。在公司积极响应市场变化,加强与国内外主要客户的合作,在市场份额和业务发展上取得了显著进展。随着产品价格持续回升,公司 24Q1 毛利率实现显著提升,相比 23Q1 增长 29.22 个百分点。
300661	圣邦股份	公司 2023 年实现营收 26.16 亿元,同比下降 17.94%,实现归母净利润 2.81 亿元,同比下降 67.86%;公司 2024 年一季度实现营收 7.29 亿元,同比增长 42.03%,实现归母净利润 0.54 亿元,同比增长 80.04%。公司 2024 年第一季度经营业绩实现大幅增长,且期间费用率有所下降,降本增效成果显著。作为国内模拟芯片龙头企业,公司产品性能和指标对标世界一流模拟厂商,目前自主研发的可供销售

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/6/21)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		产品 5,200 余款, 涵盖 32 个产品类别, 可满足客户的多元化需求, 有望受益于模拟芯片的国产替代进程。
300782	卓胜微	公司 2023 年实现营收 43.78 亿元, 同比增长 19.05%, 实现归母净利润 11.22 亿元, 同比增长 4.95%; 公司 2024 年一季度实现营收 11.90 亿元, 同比增长 67.16%, 实现归母净利润 1.98 亿元, 同比增长 69.83%。从 23Q3 开始, 消费电子市场需求迎来复苏, 公司受益华为旗舰强势回归, 23Q4、Q4 营收均实现同比增长; 2024 年第一季度, 公司 12 英寸 IPD 平台量产启动。自主 IPD 滤波器的 L-PAMiF 和 LFEM 模组已通过客户验证, 进入量产。同时, 自研 MAX-SAW 的 L-PAMiD 模组取得突破, 进入工程样品阶段。公司将集中资源, 持续优化产品性能与技术, 为未来客户推广奠定基础。
603501	韦尔股份	公司 2023 年实现营收 210.21 亿元, 同比增长 4.69%, 实现归母净利润 5.56 亿元, 同比下降 43.89%; 公司 2024 年一季度实现营收 56.43 亿元, 同比增长 30.18%, 实现归母净利润 5.58 亿元, 同比增长 180.50%, 2024 年一季度归母净利润超过 2023 年总和。随着消费市场进一步回暖, 公司下游客户需求有所增长, 伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透, 公司营业收入实现了明显增长; 同时受到产品结构优化以及成本控制等因素影响, 公司产品毛利率逐步恢复, 2024 年一季度公司综合毛利率为 27.89%, 同比提升 3.17%, 环比提升 4.99%。
688213	思特威	公司 2024 年一季度实现营收 8.37 亿元, 同比增长 84.31%, 实现归母净利润 1402.61 亿元, 同比实现扭亏为盈, 24Q1 研发投入合计为 8983.83 亿元, 占营收比重为 10.73%。报告期内, 在智慧安防领域, 受市场回暖以及公司迭代产品性能和竞争力提升的影响, 产品销量上升, 带来销售收入增加; 在智能手机领域, 公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的 XS 系列高阶 5000 万像素产品出货上升, 受此影响, 公司智能手机领域营收显著增长, 同时与客户合作全面加深, 市场占有率持续提升。在智能手机领域, 公司已成功开辟出第二条增长曲线。盈利能力方面, 受到研发效率提高、成本管理能力增强、产品成本得到有效控制等多因素的影响, 公司毛利率得到提高。
600584	长电科技	公司 2023 年实现营收 296.61 亿元, 同比下降 12.15%, 实现归母净利润 14.71 亿元, 同比下降 54.48%; 公司 2024 年一季度实现营收 68.42 亿元, 同比增长 16.75%, 实现归母净利润 1.35 亿元, 同比增长 23.01%。2023 年受到全球经济衰退的影响, 全球消费电子市场疲软, 全球半导体市场处于行业下行周期, 导致公司全年业绩承压, 但随着消费市场趋于稳定, 存储器市场回暖以及人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用, 公司 2023 年营收及净利润逐季环比抬升, 且 24Q1 实现同比双位数增长, 表明下游行业景气度正逐步回升。
002156	通富微电	公司 2023 年实现营收 222.69 亿元, 同比增长 3.92%, 实现归母净利润 1.69 亿元, 同比下降 66.24%; 公司 2024 年一季度实现营收 52.82 亿元, 同比增长 13.79%, 实现归母净利润 0.98 亿元, 同比增长 2,064.01%。据 SIA 数据显示, 2023 年全球半导体行业销售总额相比 2022 年下降 8.2%, 导致公司封测环节业务承压, 尤其是传统封测业务遭遇较大挑战。从 2023 年下半年开始, 半导体行业景气度逐步回升, 且人工智能等技术的应用成为行业增长的关键动能之一, 带动公司 24Q1 业绩实现触底回升。
688041	海光信息	公司 2024 年一季度实现营收 15.92 亿元, 同比增长 37.09%, 实现归母净利润 2.89 亿元, 同比增长 20.53%。2024 年一季度, 公司整体经营情况持续向好, 高端处理器产品的产业生态持续扩展, 涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。报告期内, 公司始终围绕通用计算市场, 保持着高强度的研发投入, 通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措, 不断增强产品竞争优势, 在收入、毛利率方面持续提升, 进一步夯实了公司的领先优势和市场竞争力, 实现了业绩的持续增长。

资料来源: iFind, 东莞证券研究所

## 6. 风险提示

(1) **终端需求不及预期:** 从 24Q1 看, 半导体行业已进入上行周期, 以智能手机为代表

的终端需求回暖对板块业绩构成支撑。若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

**(2) 国产替代不及预期：**半导体设备与材料、高端元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

**(3) 价格竞争加剧：**目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

**东莞证券研究报告评级体系:**

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内, 股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内, 股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 导致无法给出明确的投资评级; 股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明: 本评级体系的“市场指数”, A股参照标的为沪深 300 指数; 新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告, 市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告, 港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系: “保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报, “谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报, “稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报, “积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报, “激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

**证券分析师承诺:**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点, 不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系, 没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益, 或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明:**

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司, 具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下, 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有, 未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发, 需注明本报告的机构来源、作者和发布日期, 并提示使用本报告的风险, 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的, 应当承担相应的法律责任。

**东莞证券股份有限公司研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22115843

网址: www.dgzq.com.cn